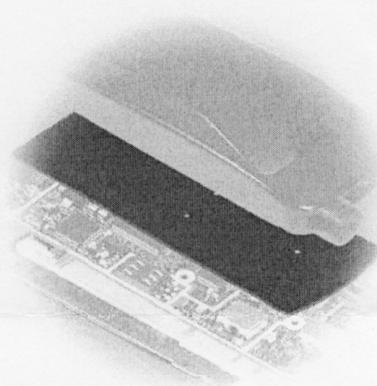


**Wärmeleitende EMV-Abschirmfolien**

Hochfrequente Schaltvorgänge in der Elektronik erfordern die Unterdrückung elektromagnetischer Einstreuungen über einen weiten Frequenzbereich. In der Leistungselektronik treten diese Einstreuungen insbesondere durch unerwünschte aber technisch unvermeidbare Oberwellen oder bei schnell getakteten Leistungsmodulen auf. Ebenso erzeugen elektronische Hochleistungsbaulemente in Computern hochfrequente elektromagnetische Störstrahlung.

KU-EC und KU-K/CU/K Abschirmfolien erfüllen die hohen gestellten Anforderungen an die Dämpfung dieser Einflüsse indem die auftretenden elektromagnetischen Einstreuungen durch Ableitung bei den Typen KU-EC/A, KU-EC/BM und KU-K/CU/K oder durch Absorption bei KU-EC/E erheblich reduziert werden. Dadurch, dass die Folien auch wärmeleitend sind, wird der thermische Gesamtübergangswiderstand sehr klein und Bauteile gefährdende Überhitzungen können vermieden werden.

**Anwendungen (Auswahl)**

Unterdrückung elektromagnetischer Einstreuungen durch Einsatz bei

- Schnell getakteten Netzgeräten
- Zwischen PCB und Gehäuse
- LSI und Kühlkörpern
- Transformatoren
- Flachbandkabel
- Leiterplatten
- Telekommunikationsmodulen
- Operationsverstärker

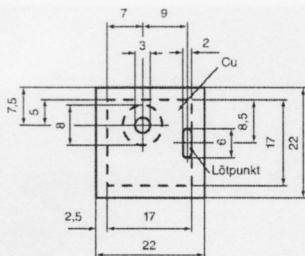
Alle Angaben erfolgen  
ohne Gewähr  
Technische Änderungen  
vorbehalten

**Gratismuster anfordern!**

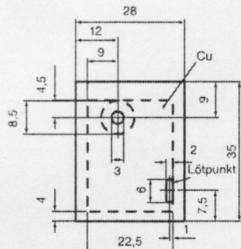
Gratismuster  
Kunze Folien  
Kunze Folien GmbH  
Postfach 10 02  
D-8500 Ingolstadt  
Telefon (0 89) 66 66 82-0  
Telefax (0 89) 66 66 82-10  
E-Mail: [kunze@heatmanagement.com](mailto:kunze@heatmanagement.com)

## EMV-Ableitende Folien KU-K/CU/K

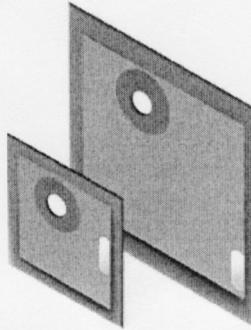
HEATPAD® KU-K/CU/K ist eine dünne Kupferfolie, die beidseitig mit Polyimidfolien elektrisch isoliert ist. Die Kupferfolie hat einen freien Punkt, der lötbar ist und zur Ableitung der elektromagnetischen Einstreuungen mit Masse verbunden wird. Die geringe Dicke und die gute thermische Leitfähigkeit des Materials tragen zu einer deutlichen Verringerung des thermischen Gesamtübergangswiderstandes bei. Somit werden Bauteile gefährdende Überhitzungen bei gleichzeitiger Dämpfung der elektromagnetischen Einstreuungen durch Ableitung vermieden. Besonders eingesetzt werden sie in hochfrequent getakteten Netzgeräten als wärmeleitende Isolierung mit hoher Abschirmwirkung.



Art.-Nr KU 6-623/K/CU/K/TO-220



Art.-Nr KU 6-624/K/CU/K/TO-247/248


**Eigenschaften**

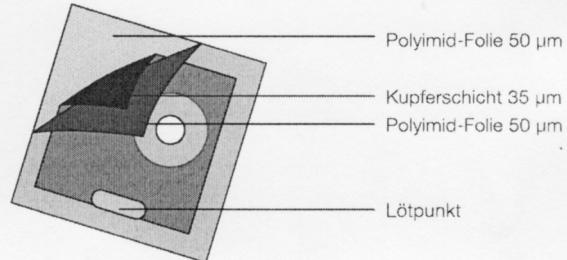
- Sehr hohe Abschirmung
- Gute thermische Leitfähigkeit
- Hohe Flexibilität
- Saubere und schnelle Verarbeitung

**Lieferformen**

- Für Standardhalbleitergehäuse TO 220 und TO 247/248/ auch ohne Loch für Klammermontage

**Auf Anfrage**

- Sonderformen nach Kundenspezifikation

**Aufbau einer K/CU/K-Folie**

**Technische Daten**

Folientyp KU- KU/CU/K

**Allgemeine Eigenschaften**

Material Aufbau (Material verklebt)

 Alle Maße in mm  
 Alle Angaben erfolgen  
 ohne Gewähr  
 Technische Änderungen  
 vorbehalten

Dicke Kupfersubstrat

µm

KU/CU/K

Polyimid - Kupfer - Polyimid

35

Gesamtmaterialdicke

140

µm

**Mechanische Eigenschaften**

Zugfestigkeit

 N/m<sup>2</sup>

KU/CU/K

124

 Zur Herstellung der Erd-  
 verbindung haben alle  
 Typen einen Lötspunkt

**Elektrische Eigenschaften**

Durchschlagsspannung

V

KU/CU/K

4000

Spezifischer Durchgangswiderstand

Ω m

KU/CU/K

 1,2 x 10<sup>12</sup>

Dielektrizitätskonstante

4.5

**Thermische Eigenschaften**

Thermische Leitfähigkeit

W/mK

KU/CU/K

0.5

 Wärmeübergangswiderstand (inch<sup>2</sup>)

°C/W

KU/CU/K

0.5

Betriebstemperatur

°C

KU/CU/K

-60 bis 200

 Bestellbeispiel  
 KU 6-623 / K/CU/K  
 Artikel / Folientyp